证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-064

天津金海通半导体设备股份有限公司关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年9月3日（周四）15:00-17:00。届时公司副总经理兼董事会秘书刘海龙先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-065

天津金海通半导体设备股份有限公司关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用已终止的“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金中的2,300万元实施全资子公司JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下简称“马来西亚槟城金海通”）的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”，并将剩余募集资金1,170.52万元永久补充流动资金。

● 变更募集资金投资项目审议程序：公司于2026年8月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，募集资金净额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月24日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	87,870.00
募集资金净额	74,681.19
募集资金到账时间	2023年2月24日
涉及变更投向的总金额	3,470.52
涉及变更投向的总金额占比	4.65%
改变募集资金用途类型	☑改变募集资金投向 □改变募集资金投资项目 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ☑实施新项目 ☑永久补充流动资金 □其他：____

注：涉及变更投向的总金额包含剩余募集资金、理财收益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准。

（二）本次实施新增募集资金投资项目的情况

公司拟将已终止的募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金3,470.52万元（包含剩余募集资金、理财收益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）中的2,300万元实施全资子公司马来西亚槟城金海通的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”，并将剩余募集资金1,170.52万元永久补充流动资金。本次拟变更投向的募集资金总金额占公司2023年首次公开发行股份募集资金净额的4.65%。

公司于2026年8月25日召开了第二届董事会战略委员会第六次会议、第二届董事会审计委员会第二十三次会议，并于2026年8月26日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同时，董事会提请股东会授权公司管理层处理与本项目实施相关的后续事宜；授权公司管理层全权办理本次境外资产购买相关事宜，包括但不限于确定交易对价、确定律师咨询、代理机构等第三方中介及其服务费用，签署相关交易文件，支付全部交易款项，完成资产交割、产权办理等事宜。本次实施新增募投项目不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东会审议。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

变更前募投项目									变更后募投项目						
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截至目前累计投入金额	已累计投入金额	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入募集资金总额	项目拟投入募集资金总额	是否构成关联交易
2023年首次公开发行股份	年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	江苏金海通半导体设备有限公司	江苏省南通市	11,066.15	11,066.15	7,847.81	7,836.23	是	2023年首次公开发行股份	购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目	JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（马来西亚槟城金海通）	马来西亚	2,300	2,300	否
										永久补充流动资金	天津金海通半导体设备股份有限公司	不适用	1,170.52	1,170.52	否

注：公司已于2025年6月终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”实施主体为江苏金海通半导体设备有限公司，项目投资总额为11,066.15万元。公司计划在江苏省南通市建设测试分选机机械零配件及组件加工生产中心。

截至2026年8月26日，该项目募集资金累计投资金额7,847.81万元，其中11.58万元系工程质保金，该款项已计入项目累计投资金额，因质保期尚未届满，暂未实际支付。

公司已于2025年5、6月履行了相关程序，同意公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资。

（二）变更的具体原因

“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”主要系用于生产公司半导体测试分选机所需的零部件，对于上述设备零部件，公司可以选择通过实施该募投项目自行生产，亦可以选择直接向供应商采购。

2025年，基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。公司借此机会，进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力，优化了供应链管理体系，从而提升了供应链的稳定性和成本效益。经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）。

三、新项目的具体内容

（一）项目基本情况

1、项目名称：购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目

2、项目实施主体：马来西亚槟城金海通

3、实施地点：PT 5932 Jalan Cassia Selatan 5/2, Taman Perindustrian Batu Kawan, Bandar Cassia, 14110, Penang

4、建设内容及投资预算：为消除长期租赁带来的经营不确定性、提升海外生产运营中心的稳定性，公司拟购置马来西亚生产运营中心目前租赁的厂房，夯实公司东南亚本地化运营与供应链布局，提升境外客户本地化服务及交付保障水平。

5、建设进度：本项目整体实施周期为1年

6、经济效益分析：基于中长期规划，购买厂房较租赁具备经济效益，拟购买（现租赁）厂房年租金约168.65万元，房产一次性购置成本约2,300万元，相当于13.64年租金，购买厂房不仅综合成本优于长期租赁，还可规避租金上涨、续租不确定等风险，增强经营稳定性。

（二）新项目必要性与可行性分析

1、必要性分析

（1）消除租赁经营风险，夯实境外生产运营中心稳定性

目前公司马来西亚生产运营中心厂房采用租赁模式，虽已完成装修投产并形成初步产能，但长期租赁存在租金上涨、租约到期等不确定性风险，不利于公司境外生产运营中心的长期稳定经营。通过购置现有厂房，能够锁定生产经营场地，化解租赁带来的经营不确定性，保障境外生产运营的连续性与稳定性。

（2）提升境外交付与本地服务保障能力，增强境外客户黏性

本次购置马来西亚生产运营中心目前租赁的厂房后，境外生产运营的稳定性将进一步增强。马来西亚生产运营中心可持续就近面向东南亚及全球境外客户开展设备交付工作，保障现有订单交付周期稳定可控，持续夯实面向境外客户的交付及售后配套服务能力，巩固与境外客户的长期合作黏性。

（3）深化公司全球化布局战略，进一步拓展境外市场

马来西亚是全球半导体制造的重要产业高地，2026年以来公司境外客户订单持续增长，仅依靠境内生产基地出口交付难以匹配境外客户的需求。本项目在已投产的马来西亚生产运营中心基础上，通过购置现有租赁厂房，打造稳定可持续的境外生产运营基地，有助于公司进一步拓展境外市场。

2、可行性分析

（1）项目前期建设基础已经完备，实施风险较低

公司前期已完成目标厂房租赁、车间装修装配、调试产线已搭建完成并实现初步生产能力，厂区基础设施、生产环境、现场管理体系均已落地运行。本次仅需购置现有租赁厂房以消除租赁经营风险，夯实境外生产运营中心稳定性，项目建设周期短、落地难度小。

（2）具备成熟的海外运营管理经验与人才储备

公司马来西亚生产运营中心自运营以来，已建立起适配当地法规、用工环境的管理体系，组建了熟悉半导体设备工艺、跨文化沟通及本地供应链管理的运营团队，为生产运营中心持续稳定生产交付提供有力保障。

（3）下游市场需求充足，业务拓展条件良好

东南亚聚集了大量国际知名封测厂商，半导体测试分选设备市场需求旺盛。经过前期经营，公司已具备一定存量境外客户基础及潜在客户储备，具备良好的业务拓展条件。

（4）项目建设方案与当地产业政策环境相适配

马来西亚半导体产业生态完善，政府对于半导体设备制造产业具备友好的营商环境。本项目系现有生产基地厂房购置，围绕公司半导体测试分选机研发、生产的主营业务展开，符合当地产业投资导向，具备良好的落地实施条件。

（三）本次交易的具体情况介绍

交易事项（可多选）	☑购买 □置换 □其他，具体为：　不适用
交易标的类型（可多选）	股权资产　☑非股权资产
交易标的名称	位于PT 5932 Jalan Cassia Selatan 5/2, Taman Perindustrian Batu Kawan, Bandar Cassia, 14110, Penang的房产
是否涉及跨境交易	☑是　□否
是否属于产业整合	□是　☑否
交易价格	□已确定，具体金额（万元）： ☑尚未确定：本次交易所涉房产购置款为1,200万林吉特，按照2026年8月25日人民币对林吉特中间价1:0.5975（即1林吉特折合人民币约1.6736元）计算，折合人民币约2,008.32万元。本次交易涉及的其他费用（包括但不限于尽调费、不动产价值评估费、律师咨询费、产权转让费、税费等政府费用等）尚未最终确定，且受汇率波动影响，交易总价将以实际支付为准。
资金来源	□自有资金　☑募集资金　□银行贷款 □其他：　不适用
支付安排	□全额一次付清，约定付款时点： ☑分期付款，约定分期条款：房产购置款拟于签署合同时支付总价款10%，其他手续办理完成后支付剩余90%；本次交易涉及的其他费用将根据后续签署的具体合同及约定执行
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否
定价方法	☑协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他：　不适用

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

新项目的市场前景详见本公告“三、新项目的具体内容”之“（二）新项目必要性与可行性分析”。

（二）本次实施新增募投项目对公司的影响

本次使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并永久补充流动资金是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，有助于公司的长期经营发展。本次变更符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况，对公司正常生产经营不会产生重大不利影响。

（三）风险提示

1、海外经营及政策环境变动的风险

本项目实施地点位于马来西亚，当地不动产交易、产权、房产税及外资房产管理等政策未来存在变动风险。若相关监管要求发生不利调整，可能影响厂房购置交割进度、增加后续物业持有成本，进而对公司马来西亚生产运营中心经营产生不利影响。

2、房产购置相关风险

本次购置现有租赁厂房，项目实施过程中，可能面临产权尽调、交易审批、过户交割、不动产税费等方面的不确定性；同时厂房购置后，海外物业将产生折旧、维护修缮等后续持有成本，若维修养护费用未来出现上涨，将增加公司马来西亚生产运营中心的长期运营开支。

3、境外运营效益不及预期的风险

购置现有租赁厂房旨在提升马来西亚生产运营中心长期经营稳定性，但境外市场拓展、客户维护及本地化生产运营受到区域市场竞争、客户需求变化、跨境供应链等多重因素影响。厂房完成购置仅解决物业长期租赁不确定性问题，而境外业务经营效果受多重外部条件制约，存在生产运营中心经营效益不及预期的风险。

五、新项目尚需有关部门审批情况

购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目为境外投资项目，尚需向主管部门申请备案，以及向相关银行申请办理外汇登记手续，并按照马来西亚当地法律法规履行相关政府机关的审批备案手续，公司将严格按照相关法律法规的要求完成项目备案审批工作。

六、保荐人或独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次变更募集资金用途事宜尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-066

天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月11日　14点30分

召开地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，相关公告已于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603061	金海通	2026/9/7

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年9月8日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）。

（二）登记地点

上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部。

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）办理登记。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式见附件1）。

4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记（须在2026年9月8日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

5、公司本次股东会不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系方式

联系地址：上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

电话：021-52277906

邮箱：jhtdesign@jht-design.com

联系人：刘海龙、蔡亚茹

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年8月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津金海通半导体设备股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“V”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-061

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通知于2026年8月24日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为2026年半年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-062）。

（三）审议通过《关于<公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

公司为深入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年12月制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。2026年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措，认真评估实施效果，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

（四）审议通过《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为消除长期租赁带来的经营不确定性、提升海外生产运营中心的稳定性，公司拟使用已终止的“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金中的2,300万元实施全资子公司JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（马来西亚槟城金海通）的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”，并将剩余募集资金1,170.52万元永久补充流动资金。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议、第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案审议通过后，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月11日召开公司2026年第四次临时股东会，审议如下议案：

序号	审议事项
1	《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年8月27日

公司代码：603061　　公司简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金海通	603061	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海龙	蔡亚茹
电话	021-52277906	021-52277906
办公地址	上海市青浦区嘉松中路2188号	上海市青浦区嘉松中路2188号
电子信箱	jhtdesign@jht-design.com	jhtdesign@jht-design.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	2,638,295,281.11	2,149,652,155.84	22.73
归属于上市公司股东的净资产	1,896,731,445.64	1,614,293,008.86	17.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	600,713,563.49	307,416,004.67	95.41
利润总额	197,368,161.29	85,797,373.60	130.04
归属于上市公司股东的净利润	171,174,638.22	76,005,538.68	125.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,553,119.22	73,814,096.57	128.35
经营活动产生的现金流量净额	57,817,362.44	16,576,701.41	248.79
加权平均净资产收益率（%）	9.93	5.61	增加4.32个百分点
基本每股收益（元/股）	2.01	0.90	123.33
稀释每股收益（元/股）	1.99	0.90	121.11

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						18,295
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
崔学峰	境内自然人	14.19	12,341,141	0	质押	3,697,500
龙波	境内自然人	8.91	7,749,012	0	质押	768,500
香港中央结算有限公司	境外法人	8.83	7,678,383	0	无	0
宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	其他	7.95	6,918,798	0	质押	2,436,000
南通华泓投资有限公司	境内非国有法人	6.20	5,393,206	0	无	0
钟格	境内自然人	4.06	3,530,000	0	无	0
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.63	3,153,958	0	无	0
天津金海通半导体设备股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	2.89	2,515,417	0	无	0
广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14	989,650	0	无	0
中信银行股份有限公司—永赢睿信混合型证券投资基金	其他	1.08	940,925	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、崔学峰、龙波为公司的控股股东、实际控制人，崔学峰与龙波为一致行动人； 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-062

天津金海通半导体设备股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，募集资金净额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月24日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金60,317.76万元，募集资金账户余额为人民币13,109.65万元。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年2月24日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	87,870.00
减：直接支付发行费用	13,188.81
二、募集资金净额	74,681.19
减：	
截至2025年12月31日已使用金额	53,804.08
2026年1-6月使用金额	6,513.68
现金管理金额	3,400.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
加：	
募集资金利息收入	2,146.39
三、报告期末募集资金余额	13,109.65

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年2月24日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801900001862	12,833.02	使用中
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005262096	64.36	使用中
江苏金海通半导体设备有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301598875	212.27	使用中
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005261995